

SRAM リフローはんだ付け条件

リフロー はんだ付け条件	実装上の注意点	対象 パッケージ	対象製品型名
最高温度: 260°C RDK-J-000068 	RDK-J-000076 	FBGA	R1LV1616HBG-4SI, R1LV1616HBG-5SI, RMLV0416EGBG-4S2, RMLV0816BGBG-4S2, RMLV1616AGBG-4U2, RMLV1616AGBG-5S2, RMLV1616AGBG-5U2, RMLV3216AGBG-5S2, RMWV3216AGBG-5S2, RMWV6416AGBG-5S2
	RDK-J-000074 	TSOP	R1LP5256ESA-5SI, R1LV5256ESA-5SI, R1LP0108ESA-5SI, R1LP0108ESF-5SI, R1LV0108ESA-5SI, R1LV0108ESF-5SI, R1LV0208BSA-5SI, R1LV0216BSB-5SI, R1LP0408DSB-5SI, R1LV1616HSA-4SI, R1LV1616HSA-5SI,
			R1RP0416DSB-0PI, R1RP0416DSB-0PR, R1RP0416DSB-2LR, R1RP0416DSB-2PI, R1RP0416DSB-2PR, R1RP0416DSB-2SR, R1RW0416DSB-0PI, R1RW0416DSB-0PR, R1RW0416DSB-2LR, R1RW0416DSB-2PI, R1RW0416DSB-2PR, R1RW0416DSB-2SR,
			RMLV0408EGSA-4S2, RMLV0408EGSB-4S2, RMLV0414EGSB-4S2, RMLV0416EGSB-4S2, RMLV0808BGSB-4S2, RMLV0816BGSA-4S2, RMLV0816BGSB-4S2, RMLV0816BGSD-4S2, RMLV1616AGSA-4U2, RMLV1616AGSA-5S2, RMLV1616AGSA-5U2, RMLV1616AGSD-5S2, RMLV3216AGSA-5S2, RMLV3216AGSD-5S2, RMWV6416AGSA-5S2, RMWV6416AGSD-5S2
	SOP(28-pin)	R1LP5256ESP-5SI, R1LV5256ESP-5SI	
最高温度: 245°C RDK-J-000070 	RDK-J-000074 	SOP(32-pin)	R1LP0108ESN-5SI, R1LV0108ESN-5SI, R1LP0408DSP-5SI, RMLV0408EGSP-4S2
		SOJ	R1RP0408DGE-2LR, R1RP0408DGE-2PI, R1RP0408DGE-2PR, R1RW0408DGE-2LR, R1RW0408DGE-2PI, R1RW0408DGE-2PR, R1RP0416DGE-2LR, R1RP0416DGE-2PI, R1RP0416DGE-2PR, R1RP0416DGE-2SR, R1RW0416DGE-2LR, R1RW0416DGE-2PI, R1RW0416DGE-2PR

SRAM ベーク (脱湿) 条件

ベーク条件	対象 パッケージ	対象製品型名
<p>125°C, 8 ~ 24時間 RDK-J-000484</p> 	FBGA	R1LV1616HBG-4SI, R1LV1616HBG-5SI, RMLV0416EGBG-4S2, RMLV0816BGBG-4S2, RMLV1616AGBG-4U2, RMLV1616AGBG-5S2, RMLV1616AGBG-5U2, RMLV3216AGBG-5S2, RMWV3216AGBG-5S2, RMWV6416AGBG-5S2
	TSOP	<p>R1LP5256ESA-5SI, R1LV5256ESA-5SI, R1LP0108ESA-5SI, R1LP0108ESF-5SI, R1LV0108ESA-5SI, R1LV0108ESF-5SI, R1LV0208BSA-5SI, R1LV0216BSB-5SI, R1LP0408DSB-5SI, R1LV1616HSA-4SI, R1LV1616HSA-5SI,</p> <p>R1RP0416DSB-0PI, R1RP0416DSB-0PR, R1RP0416DSB-2LR, R1RP0416DSB-2PI, R1RP0416DSB-2PR, R1RP0416DSB-2SR, R1RW0416DSB-0PI, R1RW0416DSB-0PR, R1RW0416DSB-2LR, R1RW0416DSB-2PI, R1RW0416DSB-2PR, R1RW0416DSB-2SR,</p> <p>RMLV0408EGSA-4S2, RMLV0408EGSB-4S2, RMLV0414EGSB-4S2, RMLV0416EGSB-4S2, RMLV0808BGSB-4S2, RMLV0816BGSA-4S2, RMLV0816BGSB-4S2, RMLV0816BGSD-4S2, RMLV1616AGSA-4U2, RMLV1616AGSA-5S2, RMLV1616AGSA-5U2, RMLV1616AGSD-5S2, RMLV3216AGSA-5S2, RMLV3216AGSD-5S2, RMWV6416AGSA-5S2, RMWV6416AGSD-5S2</p>
<p>125°C, 20時間以上 (上限72時間) RDK-J-000500</p> 	SOP(28-pin)	R1LP5256ESP-5SI, R1LV5256ESP-5SI
	SOP(32-pin)	R1LP0108ESN-5SI, R1LV0108ESN-5SI, R1LP0408DSP-5SI, RMLV0408EGSP-4S2
	SOJ	R1RP0408DGE-2LR, R1RP0408DGE-2PI, R1RP0408DGE-2PR, R1RW0408DGE-2LR, R1RW0408DGE-2PI, R1RW0408DGE-2PR, R1RP0416DGE-2LR, R1RP0416DGE-2PI, R1RP0416DGE-2PR, R1RP0416DGE-2SR, R1RW0416DGE-2LR, R1RW0416DGE-2PI, R1RW0416DGE-2PR

SRAM フローはんだ（ウェーブソルダー）可否

- 端子ピッチが0.65mmより大きいリードタイプのパッケージであれば適用可能です。

適用可否	パッケージ（ピン数）	端子ピッチ（mm）
適用可	SOP(28), SOP(32), SOJ(36), SOJ(44)	1.27
適用可	TSOP-II(32)	1.27
適用可	TSOP-II(44)	0.8
適用不可	TSOP-I(28)	0.55
適用不可	sTSOP(32), TSOP-I(32), TSOP-I(48)	0.5
適用不可	uTSOP(52)	0.4
適用不可	FBGA(48) * BGAタイプのパッケージは不可	0.75

その他 実装関連条件

項目	資料
手はんだ付け条件 Partial Heating (Soldering Iron) Conditions	RDK-J-000072 
防湿包装開封前保管条件 Storage Conditions Before Opening Moisture-Proof Packing	RDK-J-000061 
防湿包装開封後保管条件 Storage Conditions After Opening Moisture-Proof Packing	RDK-J-000062 
洗浄条件 Cleaning Conditions	RDK-J-000078 